

半导体制造崛起系列

台积电业绩延续强劲表现，大幅上调资本开支

Electronics

王亮**耿正**

SAC 执证号：

S0260519060001

SFC CE.no: BFS478

021-38003658

gfwangliang@gf.com.cn

SAC 执证号：

S0260520090002

021-38003660

gengzheng@gf.com.cn

请注意，耿正并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

Q2 业绩延续强劲表现，先进制程与 HPC 实现双重结构升级。台积电召开 26Q2 业绩会，公司 2026 年第二季度实现营收 402 亿美元，达到公司指引上端；毛利率为 67.7%，环比提升 1.5 个百分点并略高于指引。从收入结构看，7 纳米及以下先进制程占晶圆收入的 77%，较 2026 年第一季度和 2025 年第二季度均提高 3 个百分点；其中 3 纳米占比由上季度的 25%升至 30%，2 纳米首次贡献 3%。与此同时，5 纳米占比由 36%降至 33%，先进制程的增量重心正由 N5 逐步向 N3 和 N2 转移。应用端的结构变化更加明显，HPC 收入环比增长 20%，占比由上季度的 61%升至 66%，而智能手机收入环比下降 4%、占比降至 22%，AI 计算已成为公司最主要的增长动力。展望第三季度，公司预计营收为 446 亿至 458 亿美元，环比增长约 12%、同比增长约 37%，毛利率为 65%至 67%；同时把 2026 年全年美元收入增速上调至略高于 40%，强劲增长仍将延续至下半年。

公司取得结构性超额增长，大幅上调资本开支。根据 TrendForce 数据，全球晶圆代工市场在 2025 年增长 25.3%的高基数上，2026 年仍有望增长 24.8%，市场规模接近 2,000 亿美元，行业景气度继续维持高位。公司全年略高于 40%的增长指引明显快于行业预测，在 AI 芯片、先进制程和先进封装领域具备结构性超额增长优势。代理式 AI 不仅继续推动 GPU、XPU 等加速器需求，也使 CPU 在 AI 数据中心中的重要性重新上升；无论采用 x86、Arm 还是 RISC-V 架构，相关主要厂商基本都是公司客户。根据公司 26Q2 业绩会，公司管理层表示，AI 半导体的增长前景可能高于此前五年中 50%的复合增速判断，并将 2026 年资本支出由年初的 520 亿至 560 亿美元上调至 600 亿至 640 亿美元，其中 70%至 80%用于先进制程。

围绕先进制程与先进封装，公司正同步推进全球扩产及下一代技术布局。根据公司 26Q2 业绩会，为承接先进制程需求，公司将在中国台湾、亚利桑那州和日本各新增一座 3 纳米厂，并将部分 5 纳米设备转换为 3 纳米产能。更长期看，A14 采用第二代纳米片晶体管，相较 N2 可提升 10%至 15%的性能或降低 25%至 30%的功耗，计划于 2027 年风险试产、2028 年量产。先进封装方面，CoWoS 将扩展至超过 14 倍光罩尺寸，玻璃基板方案预计还需约一年成熟，COUPE 平台也将受益于 AI 数据中心对低功耗、高带宽互连的需求。

投资建议。半导体制造崛起，AI 算力需求持续增长，GPU、CPU 等多类芯片加速迭代，先进逻辑制程与先进封装有望维持较高景气。随着 N2、A14 等先进节点推进，以及 CoWoS 等封装产能持续扩张，晶圆制造、半导体设备与封装环节需求有望同步提升，建议关注产业链核心受益标的。

风险提示。下游需求不及预期；先进制程及先进封装量产进展不及预期；地缘政治风险。

相关研究

半导体制造崛起系列:ASML 业绩高于指引，订单能见度延伸至 2028 年

2026-07-16

电子行业:华为韬定律以时间缩放推动集成产业链价值重构

2026-07-08

半导体制造崛起系列:半导体零部件是设备自主可控的核心底座

2026-06-25

图 1: TSMC 26Q2 业绩摘要

Summary:					
<i>(Amounts are on consolidated basis and are in NT\$ billions unless otherwise noted)</i>					
	2Q26	1Q26	2Q25	QoQ	YoY
EPS (NT\$ per common share)	27.25	22.08	15.36	23.4%	77.4%
(US\$ per ADR unit)	4.31	3.49	2.47		
Net Revenue (US\$ billions)	40.20	35.90	30.07	12.0%	33.7%
Net Revenue	1,270.38	1,134.10	933.79	12.0%	36.0%
Gross Profit	860.31	751.30	547.37	14.5%	57.2%
Gross Margin	67.7%	66.2%	58.6%		
Operating Expenses	(98.98)	(94.01)	(84.51)	5.3%	17.1%
Other Operating Income and Expenses	5.27	1.68	0.56		
Operating Income	766.60	658.97	463.42	16.3%	65.4%
Operating Margin	60.3%	58.1%	49.6%		
Non-Operating Items	95.83	28.83	29.61		
Net Income Attributable to Shareholders of the Parent Company	706.56	572.48	398.27	23.4%	77.4%
Net Profit Margin	55.6%	50.5%	42.7%		
Wafer Shipment (kpcs 12 inch-equiv.)	4,336	4,174	3,718	3.9%	16.6%
Average Exchange Rate--USD/NTD	31.60	31.59	31.05	0.0%	1.8%
Note: Diluted weighted average outstanding shares were 25,932mn units in 2Q26					

数据来源：TSMC 业绩会材料、广发证券发展研究中心

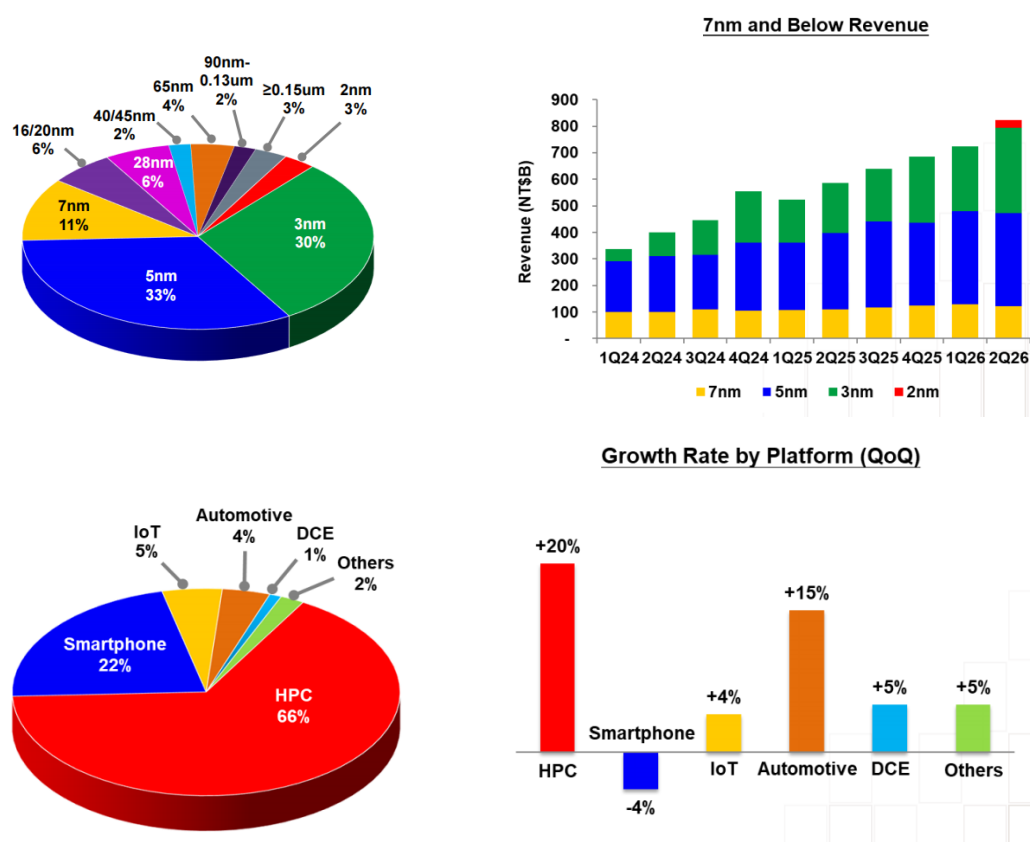
图 2: TSMC 近期重要事件

Recap of Recent Major Events

- TSMC Sold 8.1% of Vanguard International Semiconductor (2026/05/15)
- TSMC Board of Directors Approved NT\$7.00 Cash Dividend for the First Quarter of 2026 and Set September 16, 2026 as Ex-Dividend Date, September 22, 2026 as the Record Date and October 8, 2026 as the Distribution Date (2026/05/12)
- Sony Semiconductor Solutions and TSMC Entered Preliminary Agreement for Next-Generation Image Sensor Strategic Partnership (2026/05/08)
- TSMC Debuted A13 Technology at 2026 North America Technology Symposium (2026/04/23)

数据来源：TSMC 业绩会材料、广发证券发展研究中心

图 3：TSMC 26Q2 业绩拆分



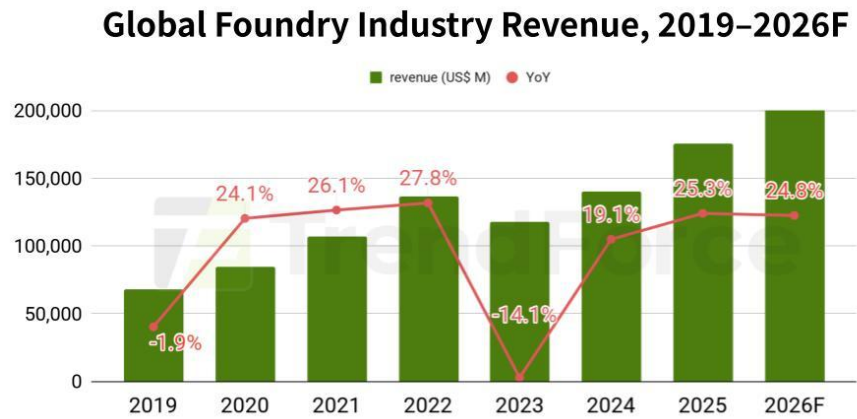
数据来源：TSMC 业绩会材料、广发证券发展研究中心

图 4：TSMC 26Q3 业绩指引

	2Q26		3Q26
	Actual	Guidance	Guidance
Net Revenue (US\$ billion)	40.20	39.0-40.2	44.6-45.8
Exchange Rate (USD/NTD)	31.60	31.7	32.0
Gross Margin	67.7%	65.5%-67.5%	65.0%-67.0%
Operating Margin	60.3%	56.5%-58.5%	56.0%-58.0%

数据来源：TSMC 公司官网、广发证券发展研究中心

图 5：2019-2026F 全球晶圆代工市场规模



数据来源：TrendForce、广发证券发展研究中心

风险提示

（一）下游需求不及预期

半导体行业具有较强的周期性，晶圆代工需求主要取决于 AI 基础设施投资及消费电子、汽车、工业等终端市场景气度。如果云服务厂商资本开支放缓，或智能手机等传统需求恢复不及预期，可能导致客户推迟订单和扩产计划，对产能利用率、收入增长及盈利能力造成不利影响。

（二）先进制程及先进封装量产进展不及预期

先进制程与先进封装技术复杂度较高，N2、A14 及 CoWoS 等技术的规模化应用取决于研发进度、良率、生产成本和客户导入情况。如果新技术研发、产能建设或量产爬坡不及预期，可能影响订单交付，并加大折旧及毛利率压力。

（三）地缘政治风险

半导体产业链全球化程度较高，容易受到地缘政治、出口管制和国际贸易政策变化影响。若贸易摩擦加剧，或海外晶圆厂建设成本、运营效率及供应链配套不及预期，可能影响全球产能布局、客户需求及整体盈利表现。

广发电子行业研究小组

耿 正：上海交通大学材料科学与工程学硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

王 亮：复旦大学经济学硕士，2014 年加入广发证券发展研究中心。

谢淑颖：厦门大学电子工程学士、上海财经大学金融硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

张大伟：复旦大学电子与通信工程硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王钰乔：上海交通大学硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

解丰源：香港科技大学电子工程学硕士，4 年半导体产业技术经验，2026 年加入广发证券发展研究中心。

刘倚天：复旦大学硕士，2025 年加入广发证券发展研究中心。

莫开寒：哈尔滨工业大学电子科学与技术学士、香港中文大学（深圳）金融硕士，2026 年加入广发证券发展研究中心。

李稼伊：香港大学硕士，2026 年加入广发证券发展研究中心。

刘芮含：上海交通大学学士，南洋理工大学硕士，2026 年加入广发证券发展研究中心。

分析师及联系人



王亮

SAC 执证号：S0260519060001
SFC CE No. BFS478
gfwangliang@gf.com.cn



耿正

SAC 执证号：S0260520090002
gengzheng@gf.com.cn

请注意，耿正并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

联系人：
解丰源
xiefengyuan@gf.com.cn

广发证券	买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
行业投资评级说明	持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
	卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券	买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
公司投资评级说明	增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
	持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
	卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们	地址	邮政编码	客服邮箱
	广州市： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 47 楼	510627	gfzqyf@gf.com.cn
	深圳市： 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	518026	
	北京市： 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	100045	
	上海市： 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	200120	
	香港： 香港湾仔骆克道 81 号广发大厦 27 楼	-	

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。